

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-074

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于质押商业承兑汇票办理银行融资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、业务概述

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年银行综合授信的议案》，同意公司向银行申请总额不超过 133,500.00 万元人民币综合授信，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官网披露的《关于预计 2023 年银行综合授信的公告》（公告编号：2022-094）；公司于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司新增银行综合授信的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在北京证券交易所官网披露的《关于公司新增银行综合授信的公告》（公告编号：2023-029）。

公司与部分客户通过商业承兑汇票进行款项结算，与供应商通过银行承兑汇票或现款结算。随着销售规模的扩大，公司流动资金需求增加。因商业承兑汇票贴现利率较高，为降低资金使用成本，公司与交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签署协议，在授信额度范围内（不超过人民币 10,000.00 万元），通过质押商业承兑汇票开具等额银行承兑汇票。

二、审议和表决情况

2023年7月5日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议表决通过了《关于质押商业承兑汇票办理银行融资业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

向银行质押商业承兑汇票并开具等额银行承兑汇票符合公司实际业务情况及经营发展需要，能有效降低财务费用，从而提升公司盈利能力，不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。

四、备查文件

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月5日